

会員限定・参加無料

令和7年度 三次元積層実装勉強会

2025年7月22日現在

| コース | No. | 題 目                            | 6月～9月                    | 10月～3月                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入門  | 1   | 半導体概論<br><対面+オンライン>            | 半導体概論<br>6月17日           | <ul style="list-style-type: none"><li>令和7年度より、会員の三次元積層実装産業への関心の醸成や、三次元積層LSIに対する理解の促進を目的として、勉強会を企画・開催</li><li>勉強会は、これまでに訪問した地域企業の皆様の声をもとに、入門レベル・初級レベルから体系的・技術的な理解を深めていただく機会として企画します</li></ul> |
|     | 2   | 半導体前工程プロセス (①～③)<br><対面+オンライン> | 半導体前工程<br>プロセス①<br>6月24日 |                                                                                                                                                                                              |
|     | 3   | 半導体後工程プロセス (①～③)<br><対面+オンライン> | 半導体後工程<br>プロセス①<br>6月24日 |                                                                                                                                                                                              |
| 初級  | 1   | 三次元積層実装                        |                          | 三次元積層実装<br>10月17日                                                                                                                                                                            |
|     | 2   | TSV形成技術                        |                          | TSV形成技術<br>10月17日                                                                                                                                                                            |
|     | 3   | 三次元積層実装適用事例                    |                          | 三次元積層実装<br>適用事例<br>10月17日                                                                                                                                                                    |

開催済みの勉強会

新たに開催日が決定した勉強会

三次元積層実装勉強会の企画・開催について(下期の概要)

|          | 初級<br>コース | 開催日               | 題目                                 | 講師    | テーマ         | 内容概要                                                                                                         | 会場<br>対面・オンライン                 |
|----------|-----------|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Day<br>I | 1         | 10月17<br>日<br>(金) | 三次元実装工学概論①<br>(60分)<br>13:35-14:35 | 福島 誉史 | 三次元積層実装     | ムーアの法則に従ったトランジスタの微細化・三次元化に加え、チップ自体を三次元構造にすることで半導体システムの性能が高まる。ここではその利点を中心にTSV以外の主要素技術を主に解説する。                 | 黒髪南W3(共用棟黒髪1)4階PBL室<br>／ZOOM併用 |
|          | 2         |                   | 三次元実装工学概論②<br>(60分)<br>14:45-15:45 |       | TSV形成技術     | 三次元実装の中で最も代表的な技術がシリコン貫通配線TSV (Through-Silicon Via)形成である。ここではTSV形成について必要なRIEやCVD、PVD、めっき、CMPに加え、最近のトレンドも紹介する。 |                                |
|          | 3         |                   | 三次元実装工学概論③<br>(60分)<br>15:55-16:55 |       | 三次元積層実装適用事例 | 三次元実装の応用例として有名なデバイスにCMOSイメージセンサがある。また、最近の生成AIではDRAMやプロセッサにも三次元実装技術が採用されている。ここではこれらの詳細について述べる。                |                                |